

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年1月4日(2022.1.4)

【公開番号】特開2021-90078(P2021-90078A)

【公開日】令和3年6月10日(2021.6.10)

【年通号数】公開・登録公報2021-026

【出願番号】特願2021-38489(P2021-38489)

【国際特許分類】

H 01 S 5/022 (2021.01)

【F I】

H 01 S 5/022

【手続補正書】

【提出日】令和3年11月16日(2021.11.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の光半導体素子収納用パッケージは、第1上面と、前記第1上面に光半導体素子が載置される載置部とを有する基板と、前記基板の前記第1上面に位置した枠体と、第2上面と、断面視において前記第2上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位置した第1側面と、前記第1側面と対向して位置した第2側面とを有する支持部と、前記基板の前記第1上面から前記支持部の前記第2上面にかけて位置するとともに、前記枠体と接合され、平面透視において前記基板から張り出した第3側面を有する入出力端子と、を備えており、側面視または断面視において、前記第3側面は、前記第2側面よりも外方に位置している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1上面と、前記第1上面に光半導体素子が載置される載置部とを有する基板と、前記基板の前記第1上面に位置した枠体と、第2上面と、断面視において前記第2上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位置した第1側面と、前記第1側面と対向して位置した第2側面とを有する支持部と、前記基板の前記第1上面から前記支持部の前記第2上面にかけて位置するとともに、前記枠体と接合され、平面透視において前記基板から張り出した第3側面を有する入出力端子と、を備えており、

側面視または断面視において、前記第3側面は、前記第2側面よりも外方に位置した、光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項2】

平面視において、前記支持部は、前記入出力端子の前記第3側面が位置する外縁に沿って位置している、請求項1に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項3】

下面視において、前記入出力端子は前記基板から張り出した第1角部を有しており、

前記第1角部は、円弧状である、請求項1または2に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項4】

下面視において、前記支持部は、前記第1角部よりも内方に収まっている、請求項3に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項5】

平面視において、前記支持部は矩形状であり、

平面視において、前記支持部の第2角部は、R面または円弧状である、請求項1～4のいずれか1項に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項6】

平面視において、前記入出力端子は、第1絶縁層と、前記第1絶縁層の上面のうち外方に張り出した箇所が上方に露出するように前記第1絶縁層の上面に位置した第2絶縁層と、前記第2絶縁層の上面のうち外方に張り出した箇所が上方に露出するように前記第2絶縁層の上面に位置した第3絶縁層とを含んでいる、請求項1～5のいずれか1項に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項7】

断面視または側面視において、前記基板の側面は、前記第3絶縁層の外方に位置した側面よりも内方に位置した、請求項6に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項8】

断面視または側面視において、前記支持部は前記第1絶縁層および前記第2絶縁層の両方と重なっている、請求項6または7に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項9】

請求項1～8のいずれか1項に記載の光半導体素子収納用パッケージと、前記基板の前記載置部に載置される光半導体素子と、前記枠体に接合される蓋体とを備える光半導体装置。